

レイアウトエディタ 多層基板作成

ここでは簡単な4層基板を例とし、多層基板を作成する手順について記載します。

配線の準備



使用する内層レイヤーを有効にします。

メインウィンドウ、システムを選択
右クリックメニューから、
デフォルトデザインルールを選択
します。

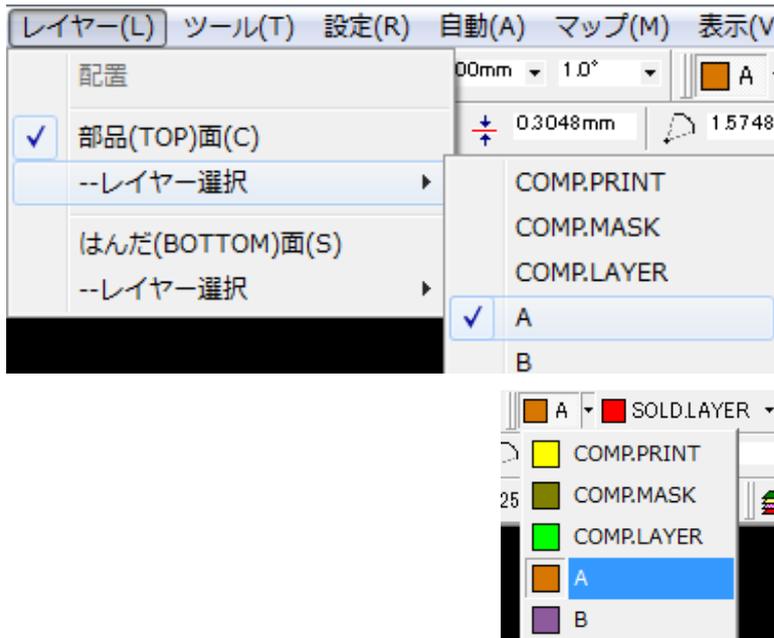


レイヤー／配線方向を選択し、使用する内層のレイヤーの値を「水平」もしくは「垂直」を選択します。

ここでは、内層レイヤーA、Zを有効にしています。



更新をクリック、承認をクリックします。



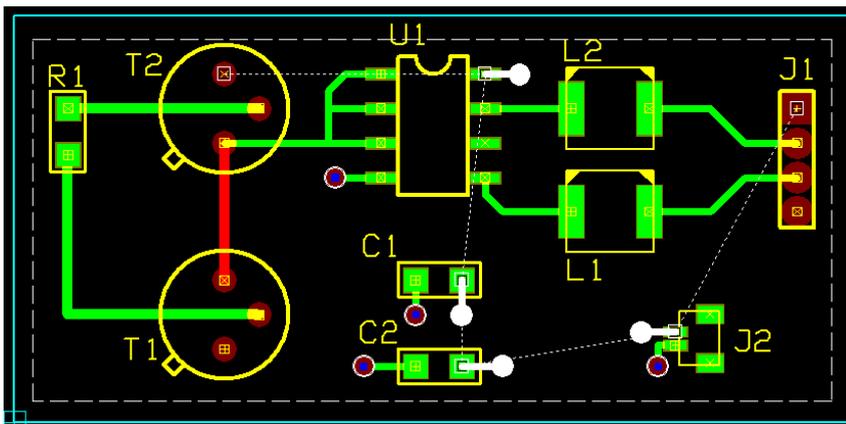
内層の配線を行う時は、レイアウトエディタ、メニューレイヤー、レイヤー選択から使用するレイヤーを選択します。

または、画面上にある、アイコンから選択します。

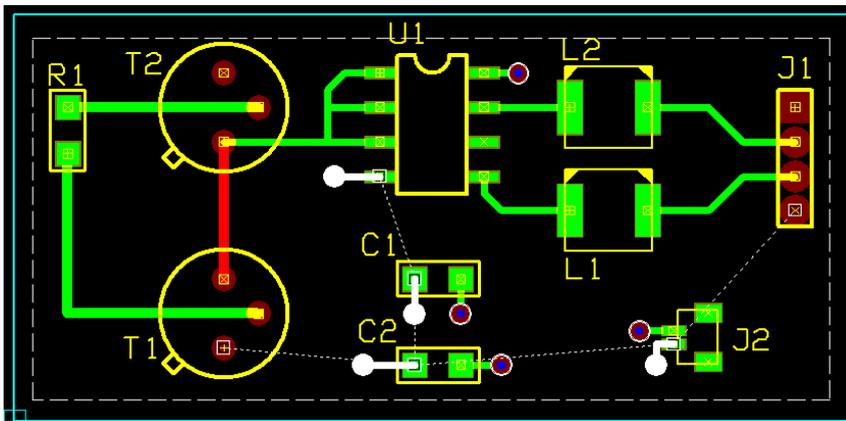
通常の配線手順通り、配線を行います。

部品面／半田面から内層レイヤーへ接続

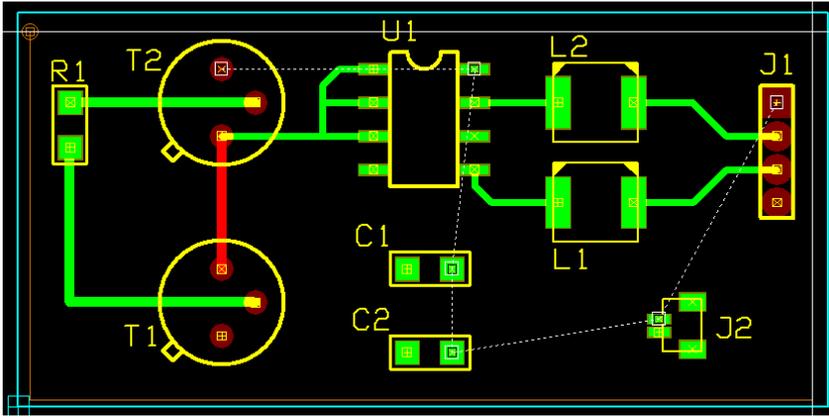
ここでは、部品面から内層のベタ面(電源、GND)へ接続する手順を記載します。



内層A、ネット「SPL1」へ接続する箇所

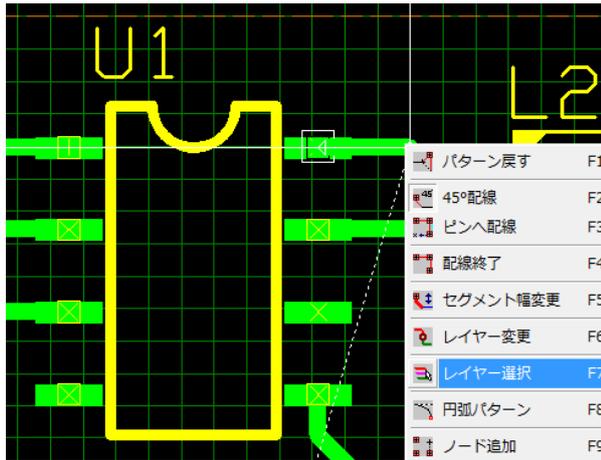


内層Z、ネット「SPL0」へ接続する箇所

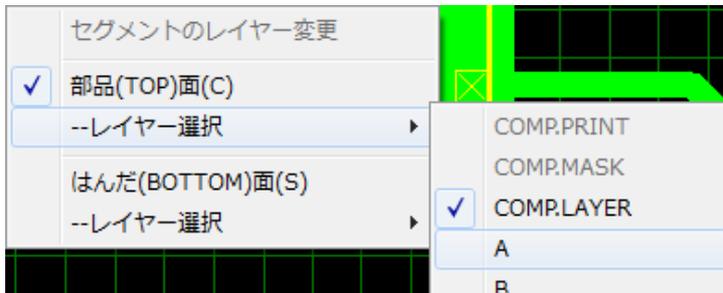


内層へベタ面を作成します。
ここでは、レイヤーAを使用して、ネット「SPL1」のベタ面を作成します。

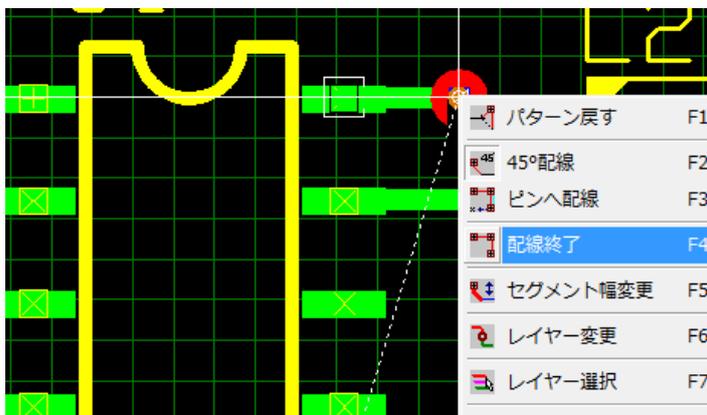
またレイヤーZを使用して、ネット「SPL0」のベタ面を作成します。



作成したベタ面へ接続します。
パッドを選択して配線を行います、ビアを挿入する位置でクリックし、右クリックメニューからレイヤー選択を選択します。

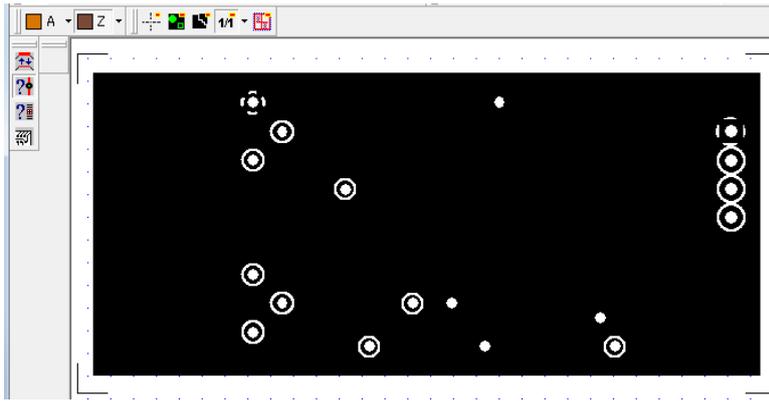


レイヤー選択から接続するレイヤーAを選択します。

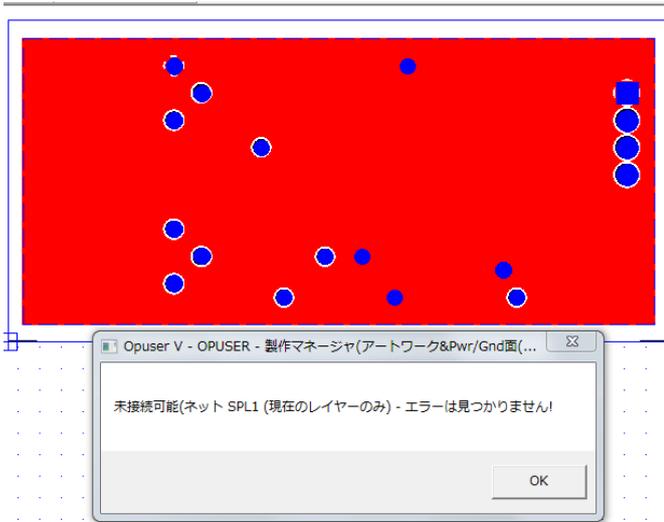


配線終了を選択します。ビアが挿入されます。

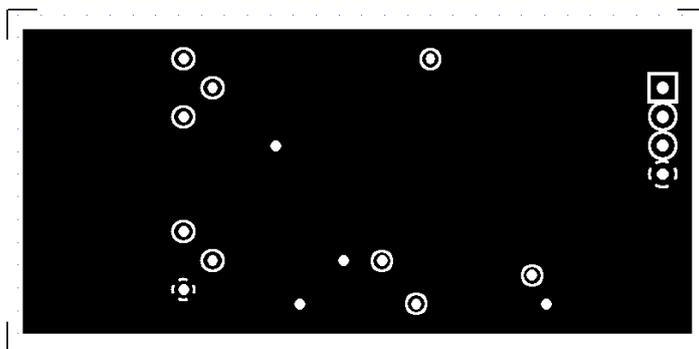
挿入されるビアは、画面上で設定されているビアが挿入されます。



製作マネージャを起動し、センターホール  を有効にすると、ビアを挿入した箇所へスルーホールがあります。



内層でのベタ接続で、チェックを行うと接続されていることが分かります。



レイヤZ、ネット「SPL0」で作成した、ベタ面には挿入したビアに設定されているエアギャップによって、絶縁されています。